

Title (en)

Process and device for the manufacturing of cast lead band

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Bleigussband

Title (fr)

Procédé et dispositif pour la fabrication de bande de plomb coulée

Publication

EP 0976474 A1 20000202 (DE)

Application

EP 99113362 A 19990710

Priority

DE 19834330 A 19980730

Abstract (en)

The cast lead strip is subjected to a deformation immediately after its solidification. As a result, an isotropic strength distribution of its material is obtained. The apparatus has cooled rotating drum (3) which is provided with an additional roll (5) directly in the solidification zone of the lead strip (2). The purpose of this roll is to deform the lead strip.

Abstract (de)

Bei einem Verfahren zur Herstellung von Bleigußband als Vorprodukt für Streckmetallgitter in Bleiakkumulatoren durch kontinuierliches Gießen eines Bleistreifens auf die gekühlte Oberfläche einer rotierenden Trommel wird das gegossene Band unmittelbar nach seiner Erstarrung einer Verformung unterzogen, die durch Rekristallisation des Bandmaterials zu einer isotropen Festigkeitsverteilung führt. Die zusätzliche Verformung erfolgt durch eine Dickenreduktion um 1% bis 25%, insbesondere 15% - 25%. Bei einer Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens ist der rotierenden, gekühlten Walze im Erstarrungsbereich des Bleibandes eine zusätzliche Walze direkt zugeordnet, die eine Verformung des Bleibandes bewirkt, oder der gekühlten, rotierenden Trommel sind eine oder mehrere Walzenpaare direkt nachgeordnet, durch die eine Dickenreduktion des Bandes erfolgt.
<IMAGE>

IPC 1-7

B22D 11/06; **B22D 11/12**; **B21B 3/00**; **B22D 21/02**

IPC 8 full level

B21B 3/00 (2006.01); **B22D 11/06** (2006.01)

CPC (source: EP)

B21B 3/003 (2013.01); **B22D 11/0602** (2013.01)

Citation (search report)

- [X] DE 674691 C 19390419 - BERNHARD BERGHAUS
- [A] US 5462109 A 19951031 - VINCZE ALBERT M [CA], et al
- [DA] DE 3317109 A1 19831117 - FURUKAWA ELECTRIC CO LTD [JP], et al
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 173 (M - 232) 30 July 1983 (1983-07-30)
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 138 (M - 480) 21 May 1986 (1986-05-21)
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 277 (M - 519) 19 September 1986 (1986-09-19)
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 384 (P - 1772) 19 July 1994 (1994-07-19)
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 262 (M - 0981) 6 June 1990 (1990-06-06)

Cited by

US10418623B2; US11417871B2; EP2828913B1

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

EP 0976474 A1 20000202; DE 19834330 A1 20000203

DOCDB simple family (application)

EP 99113362 A 19990710; DE 19834330 A 19980730